



CICMT: bitte Registrierung nicht vergessen!

Die Registrierung ist per Internet unter www.cicmt.org möglich. Bitte beachten Sie die Fristen für die reduzierte Gebühr. Die Teilnehmergebühr beinhaltet folgende Leistungen:

Technisches Programm, Proceedings, Mahlzeiten, Kaffeepausen, Abendveranstaltungen und die Ausstellung.

Von der oben genannten Web-Seite können Aussteller auch das Ausstellereinformationspaket laden.

Preise (incl. 19 % MWSt.)

	vor dem 29. Feb. 2008	nach dem 29. Feb. 2008
Member	550,- €	650,- €
Non-Member	650,- €	750,- €
Authors/Chairman	450,- €	500,- €
Student	200,- €	250,- €
Begleitperson	100,- €	100,- €

Vorläufiges Programm der CICMT in München

Inzwischen liegt das vorläufige Programm für die *CICMT*, die vom 21. bis zum 24. April in München stattfinden wird, vor. Änderungen und aktuelle Ergänzungen sind allerdings noch möglich.

1. Tag: 22. April 2008

08:30 - *CICMT Keynote Presentations*
10:00

Chip-Package-Board Co-design in High-density and High-speed Circuit Packaging

T. Harada, NEC, Japan

Sprecher: Paul G. Clem, Sandia National Lab., USA

Sprecher: Gerd Auerswald, VDO Automotive AG, Germany

10:30 - *Microsystems Materials and Processes*
12:10 K. Peterson, D. Plumlee

Multi-Component Ceramic Parts Produced by Micro Powder Injection Molding

V. Piotter, R. Heldele, K. Plewa, A. Ruh,

H.-J. Ritzhaupt-Kleissl, J. Hausselt

LTCC free-standing structures with mineral sacrificial paste

Y. Fournier, O. Triverio, T. Maeder, P. Ryser

Systematic characterisation of embossing processes for LTCC-tapes

H. Bartsch de Torres, M. Hoffmann

High Layer Count in LTCC Dual Band Antenna for Galileo GNSS

P. Uhlig, D. Manteuffel, S. Malkmus

Co-firing Processes and Dimensional Control
Hyo Tae Kim, J.H. Jean

Two different layer composited LTCC system with Low Dk and High Dk for New Wireless Applications

Je-Hong Sung, Jin-Wan Kim, Yun-Huek Choi

Investigation of the anisotropic shrinkage behaviour to improve the dimensional control in LTCC multilayer processing

M. Rauscher, A. Roosen

Stress required to densify a low-fire NiCuZn ferrite under constrained sintering

J.-H. Jean

LTCC-Modules with Ferritic Layers – Strategies for Material Development and Co-Sintering

C. Glitzky, T. Rabe, W. Schiller, M. Eberstein, J. Töpfer, S. Barth, A. Kipka

<p>Microsystems Materials and Processes K. Peterson, D. Plumlee</p>	<p>Co-firing Processes and Dimensional Control Hyo Tae Kim, J.H. Jean</p>
<p><i>Development of 3-D Channels in LTCC for Capillary Cooling Structures for Thermal Management</i> K. Jones, Feng Zheng</p>	<p><i>Validation of alternative RoHS compliant Au-pastes for the DuPont LTCC 951 system</i> B. Mussler, D. Schwanke</p>
<p>13:20 - Ceramic Actuators in Microsystems 15:00 W. Rossner</p>	<p>Nanoprocessing for Integrated Electronics Y. Imanaka, Seung Hyung Kim</p>
<p><i>Piezoelectric Properties of Pb(Zr,Ti)O₃ Thin Films for Nano Data Storage Devices</i> Seung-Hyun Kim, Chang Young Koo, Hyun-Jung Woo, Jong-Hyeon Cheon, Jowoong Ha, B. L. Wardle, Woosik Kim</p> <p><i>A Thick Film Accelerometer in LTCC-Technology – Design Optimization, Fabrication and Characterisation</i> H. Neubert, U. Partsch, D. Fleischer, M. Gruchow, A. Kamusella, The-Quan Pham</p> <p><i>Free-standing piezoelectric thick films for MEMS applications</i> C. Castille, C. Lucat, R. Von Der Mühl, P. Ginet, F. Ménil, M. Maglione</p> <p><i>Active Optical Structures by Use of PZT Thick Films</i> S. Gebhardt, A. Schönecker, C. Bruchmann, E. Beckert, G. Rodrigues, R. Bastaits, A. Preumont</p> <p><i>Feasibility study of a thick-film PZT resonant pressure sensor made on fired LTCC structure</i> M. Santo Zarnik, D. Belavic, S. Macek</p>	<p><i>Local Porosification of Fired LTCC Substrates</i> A. Bittner, U. Schmid</p> <p><i>High-Permeability (Ni,Mg)-Cu-Zn Ferrites for Integrated Multilayer Inductors based on Nanosize Ferrite Powders</i> J. Töpfer, J. Mürbe</p> <p><i>Preparation of Barium Titanate Nanoparticles from Barium Titanyl Oxalate Nanoparticles and Their Dielectric Property</i> S. Wada, S. Kondo, T. Hoshina, T. Tsurumi, Y. Kuroiwa</p> <p><i>Fabrication of SrZrO₃ Thick Films on Polymer Composites by Aerosol Deposition Method</i> S.-M. Nam, N. Mori, H. Kakemoto, S. Wada, T. Tsurumi, J. Akedo</p> <p><i>Fabrication of ceramic-based thick film substrates by aerosol deposition for the application of integration modules</i> Young Joon Yoon, Jae Chang Park, Hyung-Jun Kim, Hyun-Jun Na, Song Min Nam, Eunhae Koo, Jong-Hee Kim</p>
<p>15:30 - Microsystems Materials and Properties 17:10 A. Michaelis</p>	<p>High Frequency Characterization and Simulation M. Janezic, J. Casey</p>
<p><i>Structure and Properties of Low-temperature Sintered Ceramics</i> Hyo-Tae Kim, Myoung-Hwa Nam, Young Joon Yoon, Eun-hae Koo, Sahn Nahm, Jonghee Kim</p> <p><i>Design of LTCC with High Thermal Expansion</i> M. Eberstein, C. Glitzky, M. Gemeinert, T. Rabe, C. Modes, W. A. Schiller</p> <p><i>High Temperature Deflection in LTCC under load</i> A. Gutierrez Jr., D. Kellis, D. Plumlee, A. Moll</p> <p><i>Limiting Factors for the Application of LTCC at Elevated Temperatures</i> C. Bienert, A. Roosen</p>	<p><i>Tuneable Interdigital Capacitors at Microwave Frequency</i> J.P. Turpin, O. Maksomov, M. Fanton, V. Heydemann, J. Robinson, S. Perini, M. Lanagan</p> <p><i>Influence of Iron and Fluoride Codoping on Microwave Properties of Tunable Ba_{0.6}Sr_{0.4}TiO₃ Thick Films</i> F. Paul, A. Giere, J. R. Binder, W. Menesklou, P. Scheele, R. Jakoby, J. Haußelt</p> <p><i>Comparison of Relative Permittivity and Loss Tangent Measurements using Split-Post and Split-Cylinder Resonators</i> M. Janezic, J. Krupka</p>

Microsystems Materials and Properties

A. Michaelis

Porous ceramic membranes with 3-D structure for the microreactor application

D. Salamon, R. Lammertink, L. Lefferts, M. Wessling

Development of Low Loss and Temperature Stable BaNd₂Ti₅O₁₄ Dielectric Thick-Film by Electrophoretic Deposition Techniques

P. M. Vilarinho, Zhi Fu, Aiyang Wu, A.I Kingon

High Frequency Characterization and Simulation

M. Janezic, J. Casey

Multi-Layer Ceramic Packaging for High Frequency Mixed-Signal VLSI ASICs

L. Dove

Packaging of RF MEMS switches in LTCC

M. Lahti, J. Lenkkeri, K. Kautio, T. Vähä-Heikkilä

Ceramic Microwave Circuits for Satellite Communication

R. Kulke, G. Möllenbeck, C. Günner, P. Uhlig; K.-H. Drüe, S. Humbla, J. Müller, R. Stephan, D. Stöpel, J.F. Trabert, G. Vogt, M.A. Hein; A. Molke, T. Baras, A.F. Jacob; D. Schwanke, J. Pohlner

2. Tag: 23. April 2008

08:30 - International Special Session on Microsystems I

10:00 Yong Soo Cho, T. Tsurumi

Bottom-up fabrication of nanostructured functional materials using oxide nanosheets

M. Osada, T. Sasaki, National Institute for Materials Science, Japan

A Diplexer Embedded in heterogeneous Organic Substrates

Chan-Sei Yoo et al., Korea Electronics Technology Institute, Korea

Fabrication of Precise Fluidic Structures in LTCC

F. Barlow, J. Wood, A. Elshabini, University of Idaho, E.F. Stephens, R. Feeler, G. Kemner, J. Junghans, Northrop Grumman, USA

10:30 - Biomedical Applications

12:10 R. Eitel, A. Feteira

Micro System Technologies for Implantable Biomedical Devices

R. A.M. Receveur

Dielectrophoresis and Microfluidics: Key Methods for the Manipulation of Biological Objects Ranging from Nanoparticles to Cells

C. Duschl, M. Jaeger, M. Boettcher, C. Marschner, M. Kirschbaum, I. Guido

Biostability of Low Temperature Cofired Ceramic materials for Microfluidics and Biomedical Devices

R. Eitel, W. Zhang, J. Lumpf

Fabrication and Testing of a LTCC Microfluidic Serial Dilution Device

M. R. Gongora-Rubio, R. M. Rodrigues da Cunha, I. Dutra Alvim, M. I. Ré

Processing and Design of Integrated Passives in LTCC

Passive Power Components for Ceramic Multilayer Circuit Boards

R. Matz, D. Götsch, T. Goßner, R. Karmazin, R. Männer, B. Siessegger

Novel method for embedding high quality LTCC RF-capacitors using mid-k tapes

J. Mueller, M. Mach, R. A. Perrone

Dielectric Properties of Bismuth-Zinc-Niobium thin Films for embedded capacitor

Seung Eun Lee, Jung Won Lee, Inhyung Lee, Byung Ik Song

Filling methods for embossed low resistance fine line coils in LTCC

R. A. Perrone, H. Bartsch de Torres, M. Hoffmann, J. Müller

Biomedical Applications

R. Eitel, A. Feteira

Construction and Evaluation of Miniaturized Photometer Device for Phosphate Ion Determination Using LTCC Continuous Flow Systems

Z.M. Da Rocha, M.A.C Ferreira., N. Ibáñez-García, A.C. Seabra, J.A. Chamarro & M.R. Gongora-Rubio

Processing and Design of Integrated Passives in LTCC

Embedded Capacitor Technology using Aerosol Deposition

Y. Imanaka, J. Akedo

13:20 - **Design and Fabrication of Ceramic Microsystem a. Devices**

T. Rabe, T. Maeder

Effects of silver paste application on embedded channels in Low Temperature Co-fired Ceramics

D. Kellis, A. Moll, D. Plumlee

Development and Prototyping of a Ceramic Micro Turbine

W. Bauer, M. Müller, R. Knitter

Terahertz Wave Control Using Titania Photonic Crystals with Diamond Structure Including Plane Defects Fabricated by Micro-stereolithography

S. Kirihara, Y. Miyamoto

Experimental reliability assessment of ceramic micro-systems and interconnects in hostile environments

M. Hertl, D. Weidmann, J.-C. Lecomte

Silicon on ceramics – a new integration concept for silicon devices to LTCC

M. Fischer, H. Bartsch de Torres, M. Mach, R. Gade, M. Stubenrauch, M. Hoffmann, J. Müller

Advanced Packaging Technology

M. Oppermann, J. Vähäkangas

Micro-cone-shaped Au-bump by gas deposition method for high-density interconnection of LSI chips

F. Imura, Y. Yamaji, H. Nakagawa, M. Aoyagi, et al.

Innovative Thermal Design for High Power LED Applications

C.-P. Kluge

Aspects on Advanced Thermal Management and Reliability for Flip Chip on LTCC

M. Norén, C. Hoffmann, W. Salz, K. Aichholzer

Enhancement of fine line print resolution due to coating of screen fabrics

D. Schwanke, J. Pohlner, A. Wönisch, J. Geng

LTCC active oxygen getter module for hermetic packaging applications

T. Maeder, Y. Fournier, F. Seigneur, P. Ryser

15:30 - **Poster-Session** 17:00

LTCC standards

H. Imhoff, T. Mobley, M. Ehlert

LTCC Process Standards & iNEMI Roadmap

H. Imhoff, M. Ehlert

LTCC Processing Standards Requirements

M. Ehlert

Standard Test Methods for Measuring Relative Permittivity and Loss Tangent of Dielectric Substrates

M. Janezic, T. Mobley

Panel Discussion of the Draft LTCC Standards

M. Ehlert, H. Imhoff, T. Mobley, M. Janezic

3. Tag: 24. April 2008

08:30 - *International Special Session on Microsystems II*

10:00 J. Müller, L. Golonka

Non-Linear LTCCs and their applications

H. Jantunen, University of Oulu, Finland

Combined Manufacture Methods for high density LTCC-substrates: thick film screen-printing, ink-jet, post-firing thin film processes and laser-drilled fine-vias

A. Albertsen, K. Aruga, K. Kobayashi, K. Koiwai, KOA Europe GmbH, Germany

Shear-mode Ultrasonic Motors Using High Qm Lead-free Alkaline Niobate Ceramics

T. Tsurumi, Tokio Institute of Technology, Japan

10:30 - *Microsystems Applications*

12:10 T. Kultilainen, B. Braux

Mixed LTCC and LTTT technology for Microplasma Generator Fabrication

R. Katsuhiro Yamamoto, M. R. Gongora-Rubio, M. Rodrigues da Cunha, R. S. Pessoa, H. S. Maciel

Thick-Film Resistors as Strain Gauges for Mechanical Sensors

U. Partsch, C. Kretzschmar, H. Griessmann

Sensor hybrid circuit for imaging applications based on LTCC

R. Dohle, C. Zeilmann, J. Göbner

LTCC Hermetic Package for Optical MEMS

F. Seigneur, Y. Fournier, T. Maeder, J. Jacot, P. Rysler

Operation of Wireless Sensor Modules Inside Hermetically Enclosed Conductive Envelopes Applying Low Temperature Co-fired Ceramics Substrates

Luong v. Ngo, M. Kluge, J. Schalk, H. Seidel, U. Schmid

Direct Write Technology

P. Clem, S. Kirihara

Nanoparticle Dispersed Soft-Colloidal Gels for Material Direct Writing

H. Abe, J. Akedo

Ink-jet printing Processed Mesoporous silica microdots arrays: New Possible Platforms for the design of multifunctional sensors

B. Fousseret, M. Mougnot, M. Lejeune, F. Rossignol, J.-F. Baumard, B. Soulestin, C. Boissière, C. Sanchez, D. Jalabert, D. Massiot

Characterisation of the Dispersion Process of Functional Inkjet Inks

U. Currle, R. Moebius, K. Krueger

Effects of Pulse Voltage on Inkjet Printing of Silver Nano-Powder Suspension

Ming-Hsiu Tsai, Ping-Han Hsieh Wen-Chung Sung Weng-Sing Hwang

Laser Assisted Inkjet Printing for Metal Wiring on Glass Substrate

A. Endo, Y. Park, J. Akedo

Firmenporträt **W.C. Heraeus**

Seit einigen Monaten veröffentlichen wir an dieser Stelle in loser Folge Firmenporträts unserer Firmenmitglieder. In dieser Ausgabe: *W.C. Heraeus*

Weltweite Kompetenz in Edelmetallen und Sondermaterialien

Historie

Als der Apotheker und Chemiker *Wilhelm Carl Heraeus* im Jahre 1856 erstmals Platin in industriell interessanten

Mengen schmolz, legte er damit den Grundstock für die heutige *W.C. Heraeus GmbH*. Seit dieser Zeit hat *Heraeus* immer wieder Innovationen hervorgebracht, ungewöhnliche Technologien industriell nutzbar gemacht und sich dadurch zu einem kompetenten Partner für technische Anwendungen von Edel- und Sondermetallen entwickelt.

Gegenwart

W.C. Heraeus zählt weltweit zu den ersten Adressen im industriellen Edel- und Sondermetallgeschäft. Das Unternehmen verarbeitet die Edelmetalle Gold, Silber, Platin

und andere Platingruppenmetalle sowie die Sondermetalle Rhenium, Tantal, Niob und Beryllium primär zu industriellen und medizinischen Produkten, gewinnt Edelmetalle aus Primär- und Sekundärmaterialien und handelt mit industriellen Edelmetallen.

Heute ist das Produktspektrum von *W.C. Heraeus* aus keinem der globalen Schlüsselmärkte (wie z.B. der Automobilindustrie, Chemischen Industrie, Halbleiter- und Elektronikindustrie, Medizintechnik, Pharmazie und Lichttechnik) wegzudenken. Mit der weltweiten Präsenz – über 30 Vertriebs- und Fertigungsstätten in Europa, Nordamerika, Asien und Afrika für alle Stufen der Edelmetallgewinnung, -verarbeitung und -vermarktung – wird optimale Kundennähe und bester Service gewährleistet.

Produktportfolio der einzelnen Geschäftsbereiche der W.C. Heraeus GmbH



Thick Film Materials Division

Business Unit Thick Film

Pasten für Hybrid-Schaltkreise: Leitpasten, Dielektrikumpasten, Abdeckglasuren und Widerstandspasten von 50 m Ω /sq bis 100 M Ω /sq, Terminierungs-, Widerstands- und Kondensatorpasten für Bauelemente, LTCC-Tapes und -Pasten, metallorganische Resinate, Edelmetallfeinstpulver, Frontseiten-Metallisierungspasten für Solarzellen

Der Geschäftsbereich Dickfilm feiert in Kürze sein 40-jähriges Bestehen.

Contact Materials Division

Business Unit Assembly Materials

Bleifreie, bleihaltige Dispens- und Drucklotpasten, Waferbumping- und Ultra-Finepitch-Lotpasten, SMT-Kleber und Flussmittel, leitende und nichtleitende Kleber, Lotpasten und Leitkleber für Die-Attach-Applikationen, Feinstlotpulver, Reinigungsmedien

Business Unit Bonding Wires

Bonddrähte aus Au, Al, Al-Legierungen und Cu, Bondfolien aus Edel- und Unedelmetall, Lotfolien aus hochreinen Au-Legierungen sowie Aluminium Bänder

Engineered Materials Division

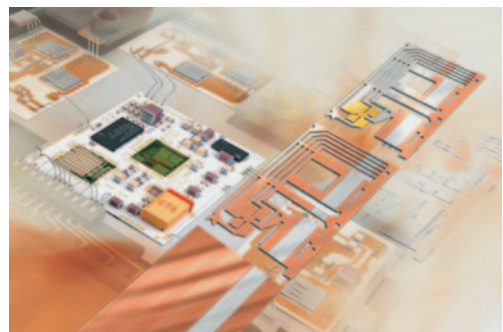


Business Unit Metal Plastic Technology

Bondbare Gehäuse für elektrische Schaltungen, MID-Bauteile, Mikrospritzgießen, 2-K-Spritzgießen, umspritzte Violdrahtschleifer

Business Unit Precision Technology

Selektiv galvanisch veredelte Präzisionsstanzbiege- und Ätzteile, Mikrokontakteile und Violdrahtschleifer, flexible Substrate für LEDs, Sensoren, RFID-Anwendungen und weitere elektronische Bauelemente, Kollektorkontakte und -bürsten für Kleinmotoren



Business Unit Semifinished Products

Walzplattierte Bänder, Manteldrähte, Potentiometerdrähte aus Pd-Legierungen, Spannbänder für Waagen, Drähte für Schleifringübertragungssysteme, Thermodrähte aus Pt-Legierungen, TK-Drähte, Zündkerzenmaterial, Bänder aus Edelmetallen und EM-Legierungen, Widerstandsdrähte

Thin Film Materials Division

Business Unit Electronics

Hochreine Sputtertargets und Aufdampfmaterialien für

- Halbleiter- und Elektronikanwendungen:
 - Front End / IC Interconnects
 - Back End / Packaging
 - Diskrete Elemente (Dioden, Transistoren)
 - Passive Elemente (Widerstände, Sensoren)

- Optoelectronics
- MEMS
- Displayanwendungen – Flat Panel Displays (LCD, PDP, OLED):
 - Transparente Elektroden
 - Black Matrix
 - Barriers, Interconnects
 - Reflective Layers

W. C. Heraeus GmbH, Heraeusstr. 12 - 14, 63450 Hanau, Tel. 06181/35-5548, Fax -3131, wc-heraeus@heraeus.com, www.wc-heraeus.de

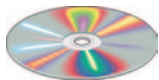
Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
München	21./24.4.2008	CICMT 2008	IMAPS NA, AcerS, DKG, IMAPS D
London, Old Windsor	11./12.6.2008	Micro Tech 2008	IMAPS UK
Greenwich	1./4.9.2008	ESTC 2008	IEEE/CPMT

Das traditionelle Seminar im Februar entfällt in diesem Jahr! Der Grund dafür ist die Ausrichtung der 4th Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies Conference (CICMT) vom 21. - 24. April 2008 in München.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der *IMAPS-Herbsttagung 2007*, die am 8./9. Oktober 2007 in München stattgefunden hat, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papiaerausdruck zum Preis von



€ 110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, und der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006 und 2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) sind noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:
 Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Neuer Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland



Liebe Mitglieder und Interessenten, der neu gestaltete Webauftritt von *IMAPS Deutschland* ist nun seit mehreren Wochen online. Hatten Sie schon einmal Gelegenheit, sich umzusehen?

Außer einem frischen Erscheinungsbild sind im Vergleich zu bisher auch mehr Informationen verfügbar. Wir würden gern auch Ihre Meinung und Vorstellungen zukünftig einfließen lassen wollen. Wenn Sie Anregungen und Wünsche haben, können Sie diese gern an den Vorstand senden.

Sie finden die Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.*

Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Str. 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Albrecht-Erhard-Str. 17

D-73433 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

Schatzmeister

c/o Hesse & Knipps GmbH

Vattmannstraße 6

D-33100 Paderborn

Fon: 05251/1560-14

Fax: 05251/1560-97

e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden

FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden

Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499

e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit

und Mikrointegration

Chip Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25

D-13355 Berlin

Fon: 030/46403-164

Fax: 030/46403-161

e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VIA electronic GmbH

Robert-Friese Straße 3

D-07629 Hermsdorf

Fon: 036601/81-529

Fax: 036601/81-530

e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1

D-10623 Berlin

Fon: 030/310078-242

Fax: 030/310078-256

e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe

Öffentlichkeitsarbeit

c/o TU Ilmenau

Fakultät EI

FG Mikroperipherik

Pf 100565

D-98684 Ilmenau

Fon: 03677/69-3429

Fax: 03677/69-3350

e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH

Klein Grötzing

D-84494 Neumarkt-St. Veit

Fon: 08722/9620-0

Fax: 08722/9620-30

e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter

Öffentlichkeitsarbeit

c/o FHTE Standort Göppingen

Robert-Bosch-Str. 1

D-73037 Göppingen

Fon: 07161/679-157

Fax: 07161/679-233

e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann

Öffentlichkeitsarbeit

EADS Deutschland GmbH

Microwave Factory / Defence Electronics

Woerthstr. 85

D-89077 Ulm

Fon: 0731/392-3879

Fax: 0731/392-3362

e-mail: martin.oppermann@imaps.de